

Manz 集团接获半导体产业新客户订单,扇外型面板级封装生产技术开启加速模式

客户为全球半导体领导制造商之一，约两千万美元的订单将影响 2022 年和 2023 年的收入及利润 | 掌握关键成长趋势，发展半导体先进封装技术，在 AI、车用、5G 三箭齐发下，符合客户需求提供组成结构更灵活且具成本优势的解决方案

活跃于全球并具有广泛技术组合的高科技设备制造商 Manz 集团，掌握半导体关键成长趋势，不断持续地开发半导体扇外型面板级封装生产技术，以创新设备以及整合解决方案备受客户关注。近日接获全球半导体领导制造商之一的大宗订单，价值约两千万美元，此订单将影响 2022 年和 2023 年的收入及利润。

新客户将采用创新的扇外型面板级封装 (FOPLP) 技术生产芯片，其关键核心技术 RDL (Redistribution Layer, 微细铜重布线层) 可有效提高 I/O 脚位数，还让产品在外型上减少体积、厚度、重量，同时降低制造成本。除此之外，还可以将各种不同功能的芯片也透过 RDL 链接，整合在单一封装体中，使芯片功能更加强大。在过去几年中，Manz 所掌握的关键核心技术已得到多家客户的验证，因此，在这个成长型的市场中已建立了地位。目前也是全球唯一的面板级封装 RDL 整厂生产设备供货商。

Manz 集团首席执行官 Martin Drasch 说道：「各产业所需的芯片数量正在急剧增加，尤其是在电动汽车和自动驾驶的大趋势带动下持续加剧。另一方面，在数字转型下，数字化应用日益增长，行动载具小型化成为基本的先决条件——也就是说，组件性能提高同时必须也达到体积缩减及成本显著降低。我们在扇外型面板级封装的全面专业知识，不论在设备及制程解决方案，皆发挥着至关重要的作用，显著降低芯片封装的体积、厚度、重量和制造成本——让我们的客户从中受益。」